سنتز لایههای نازک اکسیدروی با روش سل-ژل و کاربرد آن برای بهبود کارایی سلول های خورشیدی سیلیکونی

عليرضا جلالي ١،٢، محمد رضا واعظى ١، نيما نادري ١٠٩، فريبا تاج أبادى وعباس افتخارى ٣

¹کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی ^۳شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی ^۳سمنان شرکت صنایع الکترونیک سازان

تاریخ دریافت: ۹۸/۰۴/۱۹ تاریخ تصحیح:۹۸/۰۷/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۷/۱۷

چکیدہ

در این تحقیق لایه نازک اکسیدروی (ZnO) به عنوان لایه ضدبازتاب به روش سل-ژل و با استفاده از تکنیک پوشش دهی چرخشی بر روی سیلیکون n-yP-n از استات روی دوآبه به عنوان پیش ماده، و از مونواتانول آمین (MEA) و دی اتانول آمین (DEA) به عنوان پایدارکننده ، و از ترکیبات دومتوکسی اتانول، ایزو پروپیل الکل و اتانول به عنوان پیش ماده، و از مونواتانول آمین (MEA) و دی اتانول آمین (DEA) به عنوان پایدارکننده ، و از ترکیبات دومتوکسی اتانول، ایزو پروپیل الکل و اتانول به عنوان خلال استفاده شد. بعد از لایه نشانی، نمونه ها توسط سشوار صنعتی در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه پیش حرارت داده شد و سپس نمونه ها در دمای ۲۶۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در داخل کوره الکتریکی حرارت داده شدند و سپس اتصالات پیش حرارت داده شد و سپس نمونه ها در دمای ۴۲۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در داخل کوره الکتریکی حرارت داده شدند و سپس اتصالات فازی پشت (AI) و اتصالات فازی جلوی سلول خورشیدی(AS) را به ترتیب با روش DV و تکنیک چاپ سطحی (شابلونی) بر روی سلول خورشیدی فازی پشت (IA) و اتصالات فازی جلوی سلول خورشیدی(AS) را به ترتیب با روش (XRD)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی زلاری مشخصه یابی لایه های نازک On از پراش اشعه ایکس (XRD)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی زلاریش پارامترهای قطعه سلول خورشیدی (IN اندازه گیری مقاومت سطحی نمونه ها کمک گرفته شد. همچنین برای بررسی خواص الکتریکی و تصب گردید. برای مشخصه یابی لایه های نازک On از پراش اشعه ایکس (XRD)، تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی گسیل میدانی (FESEM) و از دستگاه پراب چهار نقطه ای برای اندازه گیری مقاومت سطحی نمونه ها کمک گرفته شد. همچنین برای بررسی خواص الکتریکی و تعیین پارامترهای قطعه سلول خورشیدی از دستگاه شبیه ساز خورشیدی استفاده شد. نتایج حاصل نشان دادند که نانو ساختار شش گوشی با اندازه ۲۰-۵۰ نانومتر بر روی سطح سیلیکون تشکیل شده و بعنوان یک لایه ضدبازتاب باعث شده که راندمان سلول خورشیدی سیلیکونی گوشی با اندازه ۲۰-۵۰ نانومتر بر روی سطح سیلیکون تشکیل شده و بعنوان یک لایه ضدبازتاب باعث شده که راندمان سلول خورشیدی سیلیکونی گوشی با اندازه ۲۰-۵۰ نانومتر بر روی سطح سیلیکون تشکیل شده و بعنوان یک لایه ضدبازتاب باعث شده که راندمان سلول خورشیدی سیلیکونی

کلمات کلیدی: سلولهای خورشیدی سیلیکونی، اکسیدروی، لایه ضدبازتاب، روش سل-ژل.

۱-مقدمه

امروزه جمعیت جهان به طور فزایندهای در حال افزایش است. و همین امرمصرف انرژی بشر را به شدت افزایش داده است. به دلیل افزایش قیمت انرژی حاصل از فراوردههای نفتی، رو به پایان بودن منابع سوختهای فسیلی و آلودگی محیط زیست، توجهات زیادی به منابع انرژی تجدید پذیر معطوف شده است. وکشورها را به سمت جایگزینی انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی بجای سوختهای فسیلی سوق داده است. لذا تلاشهای علمی فراوانی برای استفاده از انرژی منابع تجدیدپذیر صورت

^{*} **.نویسنده مسئوول:** استادیار پژوهشکده نیمه هادی ها، پژوهشگاه مواد و انرژی

گرفته است[1]. خورشید با یک ساعت تابش، ۱۰۳^۳ × ۸/۳ کیلو وات انرژی تولید می کند. که می تواند تقاضای انرژی مورد مصرف جهان را تامین نماید. به همین دلیل تحقیقات گستردهای در زمینه یافتن مواد و طراحی سیستمهای جدیدی که بتوانند، با بازدهی بالا انرژی خورشید را به دیگر انرژی های مورد نیاز تبدیل کند، در حال انجام است[۲]. با استفاده از سلولهای خورشیدی، نور خورشید به کمک یک دیود نیمه هادی مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. تبدیل انرژی در سلول خورشیدی شامل جذب نور(فوتون) توسط یک نیمه هادی و در ادامه تولید زوج الکترون–خوره و سپس جداسازی حامل های بار در پیوندگاه n-برای تولید جریان الکتریکی می باشد[۳]. زمانی یک نیمه هادی نوع n و یک نیمه هادی نوع q در کنار هم با یک اتصال متالوژیکی قرار می گیرند، یک دیود نیمه هادی (پیوندگاه n-n) تشکیل می دهند. که قطعه اصلی یک سلول خورشیدی می باشد. بعبارتی، وقتی پیوندگاه n-q شکل می گیرد، با توجه به این که چگالی حفره ها و الکترونها در دو نیمه هادی متفاوت است. حفرهها از نیمه رسانای نوع q به نیمه رسانای نوع n و الکترونها از نیمه رسانای نوع n به نیمه رسانای نوع q نفوذ می کند. در اینجا نیمه رسانای نوع q به نیمه رسانای نوع n و الکترونها از نیمه رسانای نوع n به نیمه رسانای نوع q نفوذ می کند. در اینجا میم رسانای نوع q به نیمه رسانای نوع n و الکترونها از نیمه رسانای نوع n به نیمه رسانای نوع q نفوذ می کند. در اینجا میر نمی دهد. در دیود جریان الکتریسیته فقط در یک مسیر می تواند عبور کند. و لذا پیوندگاه n-n الکترونها اجازه حفره ها را به طرف q می فرده و با حفره ها تر کیب شوند. اما پیوندگاه n-n میل یک دیود عمل می کند. و به الکترونها اجاز حفره ها را به طرف q می فرد و باعث جدائی حاملان بار می شود. حال اگر یک مسیر خارجی(مدارا) برای جریان ایجاد کنیم، حفره ها را به طرف q می فرستد. و باعث جدائی حاملان بار می شود. حال گر یک مسیر خارجی(مدار) برای جریان ایجاد کنیم، روزه ها را به طرف q می فرستد. و باعث جدائی حاملان بار می شود. حال گر یک مسیر خارجی(مدارا) برای جریان ایجاد کنیم، روزه ما را به طرف q می فرستد. و باعث جدائی حاملان بار می شود. حال آگر یک مسیر خارجی(مدار) برای جریان ایجاد کنیم، برای ما کار انجام می دهند. همچنین پیوندگاه n-q در سلول خورشیدی باعث تولید جریان الکتریسی با را فرای می و در ای ای تریزی و ای را م

بازدهی یک سلول خورشیدی عبارتست از درصدی از انرژی خورشیدی تابیده شده به سلول که به انرژی الکتریکی تبدیل شده است. در سلولهای خورشیدی(سلولهای فوتوولتایی) از نیمههادیها برای تبدیل انرژی خورشید(نور) به الکتریسیته، استفاده میکنند. در نیمههادیها اگر فوتونهای تابیده شده جذب گردند، میتوانند الکترونها را از لایه ظرفیت به لایه هدایت ببرند و باعث تولید جفت الکترون-حفره (آکسیتون) شوند. که بعد از جمعآوری حاملهای تولید شده و جدا شدن حاملهای بار توسط پیوندگاه n-n جریان الکتریکی در سلول خورشیدی انتقال مییابد. بعبارتی تنها فوتونهایی که انرژی مساوی یا بیشتر از باندگپ(گاف انرژی) ماده نیمهرسانای سلول خورشیدی دارند، قادر به رها کردن الکترون آزاد برای ایجاد جریان الکتریکی در مدار میباشند. و میتوانند در فرایند تبدیل انرژی شرکت کنند. اگر میزان انرژی فوتون بیشتر از انرژی باندگپ باشد آزادسازی الکترون اتفاق خواهد افتاد و انرژی اضافی به صورت گرما هدر(به عنوان تلفات) خواهد رفت. که این امر باعث بالا رفتن دمای سلول خورشیدی خواهد شد. ضمنا فوتونهای کم انرژی بدون جذب شدن عبور میکنند و مورد استفاده قرار نمیگیرند. ماکزیمم الکترون اتفاق خواهد افتاد و انرژی اضافی به صورت گرما هدر(به عنوان تلفات) خواهد رفت. که این امر باعث بالا رفتن دمای کند. با این فرض که هیچ تلفاتی نداشته باشیم. تلفات در سلولهای خورشیدی را میتوان شامل تلفات حرارتی، تلفات اپتیکی(نوری)، تلفات الکتریکی، و سایر تلفات در نظر گرفت. درحال حاضر با وجود کارآیی پایین سلولهای خورشیدی سیلیکونی بازار سلولهای خورشیدی به دلیل فراوانی سیلیکون در اختیار سلولهای خورشیدی سیلیکونی میباشد[۴–۸]. تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد سلولهای خورشیدی سیلیکونی انجام گرفته و همچنان ادامه دارد. مشکل سلولهای

خورشیدی فعلی، هزینه بالا،گران بودن مواد وکارائی نسبتا کم آنها میباشد. لذا تلاشها و راهکارهای زیادی برای افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی سیلیکونی و کاهش قیمت(هزینههای) تمام شده برای تولید سلولهای خورشیدی انجام میشود [۹].

این تحقیقات در زمینههای مختلفی مانند خالصسازی سیلسیم، استفاده از پوششهای ضدبازتاب روی سطح سلول، منسوج کردن و ایجاد ناهمواری روی سطح سلول (بافت دار کردن سطح)، به کارگیری سطوح ناهموار برای کاهش بازتابش، به داماندازی نور برای جذب بیشتر نور، کاهش سطح اتصالات فلزی روی سلول، ضخیم کردن سلول برای افزایش جذب فوتونها، و...در حال انجام می باشد[۱۰–۱۱]. میتوان گفت، که قسمت قابلتوجهی از نورتابیده شده به سلول خورشیدی بدلیل بازتاب از دست میرود و توسط سلول جذب نمیشود. پوششهای ضد بازتاب با افزایش نور ورودی در ناحیه فعال سلول خورشیدی نقش مهمی را در بهبود عملکرد و افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی سیلیکونی ایفا میکنند. پوششهای ضدبازتاب با تله گذاری نور و بداماندازی نور باعث افزایش طول مسیر عبور نور و افزایش ضریب جذب نور و در نتیجه افزایش زوج الکترون–حفره و افزایش جریان میشوند[۱۲]. در یک پوشش ضدبازتاب دو پارامتر ضریب شکست و ضخامت پوشش از بقیه پارامترها تعیین کنندهتر میباشند.

هدف از پوشش ضد بازتابش اینست که اختلاف میان ضریب شکست محیط و سلول خورشیدی سیلیکونی به حداقل برسد. بعبارتی می توان گفت، هر چه ضریب شکست یک ماده با ضریب شکست هوا (۱=n) هماهنگتر و نزدیکتر باشد، بازتاب از سطح آن ماده کمتر میشود. لذا برای رسیدن به راندمان بالا لایه ضدبازتاب را به گونهای تنظیم میکنیم، که ضریب شکستش با هوا تقریبا یکسان باشد. موادی که به عنوان پوشش ضد بازتاب به کار میروند، معمولاً دارای ضریب شکست کمتری نسبت به نیمرسانای به کاررفته در سلولهای خورشیدی میباشند. این پوششها با کاهش ضریب شکست سطح نیمرسانا، بازتابندگی سطحی را کم میکنند. و میتوانند از جنسهای مختلفی مانند SiO₂,Si₃N4 یا کاهش ضریب شکست سطح ایمرسانا، بازتابندگی های نازک سیلیکون نیترید (Si₃N4) که بوسیله روش بخار شیمیایی پلاسمای افزایش یافته (PECVD) لایهنشانی میشود، استاندارد صنعتی برای پوششهای ضدبازتاب روی سطح سیلیکونی میباشد.لایههای نیترید سیلیکون با شیوههای متفاوتی از جمله روش رسوبدهی شیمیائی بخار(*LPCVD PECVD*)، روش کندوپاش و...لایهنشانی میگردد[۳۱–۹۱]. متاسفانه روش های تولید پوشش ضدبازتاب به تجهیزات پیچیده گران قیمت نیاز دارد و معمولا این روشها هزینه بالایی دارند [۲۰–۲۱]. امروزه محققان سعی دارند، با پوششهای ضد انعکاسی نانوساختار که با روشهای ساده تهیه می شوند، جایگزینی مناسب برای پوشش های ضدانعکاسی مورد استفاده در سلولهای خورشیدی پیدا کنند. در این پروژه تلاش می شود، با توجه به خواص ویژه و های ضدانعکاسی مورد استفاده در سلولهای خورشیدی پیدا کنند. در این پروژه تلاش می شود، با توجه به خواص ویژه و های ضدانعکاسی مورد استفاده در سلولهای خورشیدی پیدا کنند. در این پروژه تلاش می شود، با توجه به خواص ویژه و منحصربفرد لایههای نازک اکسیدهای رسانای شفاف نظیر شفافیت اپتیکی بالا در ناحیه مریی(بیشتر از ۷۵ درصد) و رسانائی مناف، منحصربفرد لایههای نازک اکسیدهای رسانای شفاف نظیر شفافیت اپتیکی بالا در ناحیه مریی(بیشتر از ۷۵ درصد) و رسانائی مفاف، الکتریکی بالا (¹⁻ ۲۳⁻¹ ۲۳ یا بیشتر) عملکرد سلولهای خورشیدی را بهبود بخشیم. از میان اکسیدهای رسانای شفاف، می باشد [۲۲]. که دارای خواص الکتریکی و نوری عالی، قابلیت تحرک الکترونی بالا، شفافیت خوب در بازه طول موجهای مرئی می باشد[۲۲]. که دارای خواص الکتریکی و نوری عالی، قابلیت تحرک الکترونی بالا، شفافیت خوب در بازه طول موجهای مرئی می باشد [۲۲]. که دارای خواص الکتریکی و نوری عالی، قابلیت تحرک الکترونی بالا، شفافیت خوب در بازه طول موجهای مرئی است. که بشدت نور *U* را جذب و نوری عالی، قابلیت تحرک الکترونی بالا، شفافیت خوب در بازه طول موجهای مرئی نبودن آن باعث شده درسالهای اخیر تمایل به استفاده از آن به عنوان رسانای شفاف بیشتر شود[۲۴]. و لذا می توان از *ZnO* را عبور می دهد [۲۲]. همچنین بخاطر ارزان بودن و زیست سازرگار بودن و سمی نبودن آن باعث شده درسالهای اخیر تمایل به استفاده از آن به عنوان رسانای شفاف بیشتر شود [۲۰]. و نوا می مرئی را عبور می دهد [۲۲]. همچنین بخاطر ارزان بودن و زیست سازرگار بودن و سمی نبودن آن باعث شده درسالهای اخر تمایل به استفاده از آن به عنوان رسانای شفاف بیشتر شود ایزی را عبور می می نون از تمای تمان می نون نشاف بی بورژه به دنبال ایجاد همزمان به میزان شفافیت نبودن آن باعوب و رساندگی یا در لایه می توان ازی می توان از تمایلی بالا در لایههای نازک موری می شود. ایزی موی و می شیلی می نویزی می توان می می توان رفتی مران به میزان شفافیت نور و و

۲-بخش تجربی

۲-۱-شتشوی نمونه

ابتدا نمونههایی از ویفر سیلیکونی p-n به ابعاد ۲×۲ تهیه شد. برای برش زدن ویفرهای سیلیکونی از لیزر Nd-YAG با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر استفاده شد. به منظور دستیابی به لایهای با کیفیت خوب در روش سل-ژل کنترل پارامترهای سنتز بسیار مهم میباشد[۲۵]. یکی از پارامترهای تاثیرگذار و مهم بر رشد و مورفولوژی لایهها تمیزکاری زیرلایه میباشد. برای تمیزکردن زیرلایه سیلیکونی (ویفر سیلیکونی n-n) ابتدا با استفاده از مواد شوینده زیرلایه را شسته و سپس زیرلایه در داخل محلولی از اسیدسولفوریک و آب اکسیژنه به نسبت حجمی ۳ به ۱ به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه قرار داده شد. سپس نمونه را با آب مقطر شسته و آن را در داخل محلول رقیقی از HT(۱تا ۱۹٫۵ مولار) به منظور حل شدن SiO² احتمالی به مدت ده دقیقه قرار داده شد. سپس نمونه را با آب مقطر شسته و آن را در محلولی از استن و اتانول در داخل دستگاه التراسونیک به مدت ۱۰ الی ۱۵ سپس نمونه را با آب مقطر سه بار تقطیر شستشو داده شده و در داخل آون خشک گردید. بعد از شستشوی ویفرها، مقاومت سطحی (R_s) نمونه توسط دستگاه پروب چهار نقطهای اندازه گیری شد. مقاومت سطحی (صفحهای) به صورت اهم بر مربع با نماد Ω/sq یا Ω/sq بیان می شود.

$R_s = 1800 \,\Omega/\Box$

۲-۲- لایهنشانی Al در پشت نمونه به روش *PVD*(لایه نشانی فیزیکی بخار)

در سلولهای خورشیدی سیلیکونی لایه رسانای پائینی از مادهای با رسانائی بالا و به اندازه کافی ضخیم ساخته می شود، تا جریان را بخوبی هدایت کند. و معمولا ازجنس آلومینیوم و یا مولیبدنییوم می باشد. به منظور لایه نشانی Al درپشت ویفر سیلیکونی از روش تبخیر حرارتی مبتنی بر مقاومت الکتریکی(روش تبخیر مقاومتی) که یکی از روش های PVD می باشد، استفاده شد. در این روش خلاء مورد نیاز ۵-۱۰×۲ تور و ولتاژ مورد نیاز ۷۵ ولت در نظر گرفته شد.

۲-۳- قرار دادن نمونه در داخل کوره دیفیوژن

در این مرحله به منظور افزایش حاملهای اکثریت، نمونه را داخل کوره دیفیوژن به مدت ۳ دقیقه در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد، تا AI کاملا در داخل Si نفوذ کند. در این مرحله حفرهها بیشتر شده بعبارتی P به +P تبدیل میشود.

۲-۴- لایهنشانی ZnO توسط روش سل- ژل با استفاده از تکنیک اسپین کوتینگ

همانگونه که میدانیم، کنترل پارامترهائی از قبیل دما، pH، غلظت واکنش دهندهها، نوع پایدارساز و نوع حلال که به پارامترهای سنتز موسوم هستند. در روش سل-ژل از اهمیت ویژهای برخودار هستند [۲۶–۲۷]. در این پروژه برای محلول سازی از استات روی دوآبه(به عنوان پیش ماده) با حلال های مختلفی از قبیل اتانول ، ایزوپروپیل الکل، دو متوکسی اتانول و مخلوط هرکدام از هر حلال های فوق و همچنین از پایدارسازهای مختلفی مانند مونواتانول آمین ، دی اتانول آمین با زمان ماندگاری محلول به مدت ۱۰، ۵، ۸، ۱۲، ۱۴ ساعت استفاده شد [۲۸–۳۲]. همچنین برای لایه نشانی به روش اسپین گوتینگ در سرعتهای متفاوت و زمان های متفاوت لایه نشانی انجام شد. بعد از لایه نشانی به مدت چند دقیقه هوای گرم بطور دمشی توسط سشوآر صنعتی بر روی نمونه در دماهای مختلف عبورداده شد. سپس نمونه در دمای ۲۰۰–۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در کوره الکتریکی قرار داده شد.

شرایط لایهنشانی ZnO: ۲/۵ ۲/۵ گرم استات روی با ۴۰ سی سی حلال دومتوکسی اتانول و ۱/۵ سی سی اتانول آمین در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ دقیقه هم زده شد و بعد از گذشت ۸ ساعت (زمان ماندگاری محلول)، توسط تکنیک اسپین گوتینگ با سرعت ۲۲۰۰rpm/min به مدت ۲۵ ثانیه لایهنشانی انجام شد. بعد از لایهنشانی نمونه به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بطور دمشی توسط سشوآر صنعتی در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس نمونه در دمای ۴۷۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت در کوره الکتریکی قرار داده شد. بعد از لایهنشانی بوسیله دستگاه پروب چهارنقطهای مقاومت سطحی نمونه اندازه گیری شد.

 $R_s = 290 \,\Omega/\Box$

۲−۵- لایهنشانی Ag (اتصال فلزی روی سلول) به روش چاپ سیلک^۱

اتصالات فلزی فوقانی برای جمع آوری جریان تولید شده توسط سلول خورشیدی مورد نیاز میباشد. باسبارها مستقیما به بار بیرونی متصل بوده و فینگرها کار جمع آوری جریان از سطح سلول و رساندن آن به باسبار را به عهده دارند. در این مرحله به کمک تکنولوژی چاپ سطحی، اتصالات بر روی سلول پرینت می شود (شکل ۱). این روش فرآیندی به نسبت ساده با کارائی خوب و هزینه پائین می باشد. در این روش با استفاده از شابلون، خمیر نقره روی ویفر چاپ شده و یک شبکه اتصالات بر روی سلول قرار داده می شود و سپس با قرار دادن نمونه درداخل کوره دیفیوژن در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۵ دقیقه نقره بر روی سطح سلول نفوذ می کند و اتصالات فلزی ایجاد می شود.



شکل۱: شابلون تهیه شده برای روش چاپ سیلک

۳-بحث و نتیجه گیری

۱-۳-نتايج اوليه

با استفاده از دستگاه پروب چهار نقطهای مقاومت سطحی قبل از لایهنشانی و بعد از لایهنشانی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقاومت سطحی زیرلایه بعد از لایهنشانی به طور قابل ملاحظهای کاهش پیدا کرده است.

$R_s = 1800 \Omega/\Box$	قبل از لايەنشانى:
$R_s = 290 \Omega/\Box$	بعد از لايەنشانى:

[\] Screen printing

۲-۳- مشخصه یابی ساختاری

X -۲-۲- الگوی پراش اشعه

برای بررسی ساختار بلوری لایههای نازک اکسیدروی (ZnO) لایهنشانی شده از پراش اشعه ایکس استفاده شد. شکل۲ الگوی پراش اشعه X یک ساختار اکسیدروی که توسط روش سل-ژل با استفاده از تکنیک اسپین کوتینگ تهیه شده است، را نشان می دهد. همانطور که در شکل ۲ مشاهده می شود، لایه نازک ZnO بر روی زیرلایه سیلیکون شکل گرفته است. اکسیدروی در این نمونه دارای چهار قله پراش می باشد که با hkl ، (۱۰۰)، (۱۰۲)، (۱۰۴)، (۱۱۴) به ترتیب در مکانهای (۳۳/۳۵۹۰ این نمونه دارای جهار قله پراش می باشد که با JCPDS 5-00664 واقع شدهاند. همانطور که مشخص است در الگوی پراش اشعه X ، پیک ترجیحی (۱۰۰) طبق کد استاندارد JCPDS 5-00664 واقع شدهاند. همانطور که مشخص است در الگوی براش اشعه X ، پیک ترجیحی (۱۰۰) در مکان ۳۳/۳۵۹۰ وازر دارد. جدول ۱ معرف مکان قلهها، مقادیر FWHM، اندازه بلورک، کرنش، چگالی نابجائی و ثابت شبکه لایه نازک ZnO می باشد. همانطور که مشاهده می شود بر اساس پیک اصلی که در راستای ۱۰۰ می باشد اندازه بلورک(اندازه کریستالیت) برابر با ۳۳ نانومتر محاسبه شده است.

 $D = 0.9\lambda/\beta \cos\theta \qquad (1)$

که در این رابطه β ،θ ،λ ،D به ترتیب اندازه متوسط بلورکها، طول موج پرتو ایکس اعمال شده (Cu_{kα} (λ =1.542A⁰). زاویه راش اشعه ایکس و یهنای قله در نصف بیشینه (FWHM) می باشند.

از رابطه ۲ برای محاسبه کرنش استفاده شده است، که در آن D اندازه بلورک میباشد.

$$\varepsilon = 1/D^2 \tag{(7)}$$

و برای محاسبه چگالی نابجائی()) از رابطه ۳ استفاده گردید.

 $\delta = (\beta cos\theta)/4 \tag{(7)}$



شکل ۲: الگوی پراش اشعه X لایه نازک ZnO/Si

2Theta (2θ)	2Theta	FWHM		Crystallite	Strain*10 ⁻³	Dislocation density*10 ⁻⁴	lattice constant(A ⁰)	
	*10 ⁻³ (Radian)	d-spacing	size(D) (nm)	(E) $(nm)^{-2}$	(δ)	a=b	с	
	33.3590	10.000	2.6838	33.0000	2.3980	9.1827	3.0989	5.2369
	46.1480	9.9433	1.9654	36.0000	2.2870	7.7160		
	72.0820	8.2338	1.3092	66.0000	1.6645	2.2957		
	98.0870	10.400	1.0200	50.0000	1.7095	4.0000		

ZnO جدول ۱: داده های مستخرج ازالگوی پراش اشعه X لایه نازک

و از رابطه * برای تعیین ثابت شبکه استفاده شد.که در آن d فاصله صفحات شبکه میباشد.

$$\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \left\{ (h^2 + hk + k^2)/a^2 \right\} + (l^2/c^2)$$
(f)

(FESEM) تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FESEM)

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی می توان تصاویری با بزرگنمایی و قدرت تفکیک بسیار بالا در حد نانومتر از ماده بدست آورد. برای بررسی مورفولوژی و توپوگرافی نمونهها تصاویر FESEM آنها ثبت گردیده است. که نتایج آنها در شکل۳ نشان داده شده است.



شکل۳: تصاویر FESEM الف: نانوذرات ZnO که اندازه ذرات آن کمتر از ۵۰ نانومتر است. ب: تصویر برش مقطعی

در تصاویر FESEM دانه های سفید رنگ انباشتگی ذرات اکسیدروی را نشان می دهد که بصورت خوشهای در آمدهاند. انتظار می رود که ذرات ZnO در کنار هم قرار گیرند، اما چون در اینجا از روش سل-ژل و تکنیک اسپین گوتینگ استفاده می کنیم، ممکن ذرات اکسیدروی بجای اینکه در کنار هم چیده شوند روی هم انباشته شوند بعبارتی بعد از اینکه در بار اول لایه نشانی انجام شد، ممکن است در دومین بار لایه نشانی در قسمتی از نمونه کشش های سطحی بیشتر شود و لذا جذب محلول بیشتر شده و برجستگی سیار کوچکی ایجاد شود. و به همین دلیل این انباشتگی تا پایان مرحله لایه نشانی ادامه پیدا خواهد کرد. شده و برجستگی ها و فرورفتگی های ناخواسته که در اینجا به خاطر روش سل-ژل ایجاد شده اند می تواند باعث بافتی شدن سطح بیشتر شود و لذا جذب محلول بیشتر شده و برجستگیها و فرورفتگی های ناخواسته که در اینجا به خاطر روش سل-ژل ایجاد شده اند می تواند باعث بافتی شدن سطح برجستگیها و فرورفتگی های ناخواسته که در اینجا به خاطر روش سل-ژل ایجاد شده اند می تواند باعث بافتی شدن سطح برجستگیها و فرورفتگی های ناخواسته که در اینجا به خاطر روش سل-ژل ایجاد شده اند می تواند باعث بافتی شدن سطح نوان گفت، که اندازه نمونه بیار کوچکی ایجاد شود. و به همین دلیل این انباشتگی تا پایان مرحله لایه نشانی ادامه پیدا خواهد کرد. و برجستگیها و فرورفتگی های ناخواسته که در اینجا به خاطر روش سل-ژل ایجاد شده ای تواند باعث بافتی شدن سطح نور بیشتر شود. با توجه به شکل الف می توان گفت، که اندازه نمونههایی که رشد داده ایم بین ۳۰ تا ۵۰ نانومتر می باشد و این موضوع می تواند نشانگر یک لایه نشانی یکنواخت باشد. در شکل ب همانطور که مشاهده می شود تصویر برش مقطعی از نمونه سیلیکون لایه نشانی شده با ZnO گرفته شده است. و نشان می دهد که ZnO بر روی لایه سیلیکون (endet)، به خوبی رشد پیدا کرده و همه سطح سیلیکون را به موسید و نشان می در تمانور باعث ای می و شده با ZnO گرفته شده است. و نشان می دهد که ZnO بر روی لایه سیلیکون (endet)، می باشد و است. و نشان می دهد که ZnO بر روی لایه سیلیکون (endet)، می شده است. و نشان می دهد که ZnO بر روی لایه سیلیکون (endet)، می شده است. و نشان می دهد که ZnO بر روی لایه سیلیکون (endet)، می توربان کرده و همه سطحی تقریبا می حرفره روی و دا کا ناومتر ایجاد شده است. باتوم می داوی حرمانی کره رمان کره را می می شده است.

۳–۳–خواص الكتريكي

1-۳-۳-منحني جريان-ولتاژ

ابتدا توسط دستگاه چهارنقطهای مقاومت سطحی ، ولتاژ و جریان اندازه گیری شد.

$$R_s = 290 \,\Omega/\Box$$
 $V = 500 - 550 \,mV$ $I = 2 - 3 \,mA$

برای بررسی مشخصه جریان- ولتاژ دیودی نمونه، از روند زیر بهره گرفته شده است.

۱) ابتدا نمونه را در داخل محفظه مخصوص دستگاه IV قرار داده شد و بعد از انجام تنظیمات منحنی جریان-ولتاژ قطعه در تاریکی گرفته شد. یکی از اندازه گیری رایج در صنعت فتوولتائیک اندازه گیری جریان-ولتاژ در تاریکی میباشد. همانطور که در شکل ۴ مشخص است، نمونه های رشد داده شده رفتاری همچون یک سلول خورشیدی را نشان میدهند، بدان معنا که در مقادیر ولتاژ منفی، از روندی کاهشی به سمت جریان های کمتر از صفر که مشخصه دیودها (شاتکی) است پیروی نمی کنند و این نشان دهنده روندی صحیح و مطلوب در فرایند لایه نشانی با هدف ساخت قطعه سلول خورشیدی است.



شكل ۴ : منحني جريان-ولتاژ

۲) جهت بررسی اثر نور بر روی قطعه، آن را تحت تابش نور قرار دادیم. و منحنی جریان-ولتاژ قطعه گرفته شد. شکل ۴ نشان دهنده منحنی جریان ولتاژ نمونهها در حضور و عدم حضور نور میباشد. نکته اولیه در این نمودارها، واکنش نمونه نسبت به حضور نور می باشد. نکته اولیه در این نمودارها، واکنش نمونه نسبت به حضور نور می باشد، نکته اولیه در این نمودارها، واکنش نمونه نسبت به حضور نور می باشد، می باشد، چنانچه هیچ واکنشی رخ ندهد یا تغییرات در حضور تابش نور بسیار ناچیز باشد، نشان دهنده عدم دستیابی به قطعه ای با مشخصههای مطلوب است. هرچند جهت مطالعه دقیق تر این موضوع می بایست نمونه آماده شده را تحت تابش نورهای با مشخصههای مطلوب است. هرچند جهت مطالعه دقیق تر این موضوع می بایست نمونه آماده شده را تحت تابش نورهای مختلف با نواحی فرکانسی متفاوت قرار داد. و سپس رفتار آن را بررسی کرد، لکن در مطالعه حاضر صرفا تغییرات نمونه تحت تابش نور های مختلف با نواحی فرکانسی متفاوت قرار داد. و سپس رفتار آن را بررسی کرد، لکن در مطالعه حاضر صرفا تغییرات نمونه

هنگامی که نور توسط سلول خورشیدی جذب میشود، آکسیتونهای متعددی (بسته به شدت و فرکانس نور تابشی) بوجود میآیند. این زوجهای الکترون-حفره بسیار مقید بوده و تمایل زیادی به بازترکیب با یکدیگر دارند، پس لازم است، تا در کمترین زمان از قید یکدیگر خارج شده و خود را به محل اتصالها برسانند. یکی از عواملی که می تواند این جداسازی را تسهیل کند، استفاده از اتصالهای فلزی با تابع کارهای متفاوت در دو طرف قطعه سلول خورشیدی است. که در این بررسی از نقره و آلومینیوم استفاده شده است. حال چنانچه قطعه در جداسازی حاملهای بار از یکدیگر موفق عمل کرده باشد، می بایست اختلاف پتانسیل دو سر قطعه در هنگام تابش نور روندی افزایشی را از خود نشان دهد. با رجوع به شکل ۴ می توان این روند افزایشی را در نمودار نقطه چین برای نمونه تحت تابش نور سفید مشاهده کرد. این موضوع نیز می تواند تاییدی بر عملکرد صحیح قطعه مهیا شده در این تحقیق باشد.

۳) در مرحله دوم قطعه صرفا در معرض نور سفید جهت بررسی رفتار صحیح آن قرار داده شد، لکن جهت دستیابی به مقادیر اصلی و مشخصه یک سلول خورشیدی می بایست آن را تحت تابش نور خورشید قرار داد. مسلما بررسی این موضوع در هوای آزاد و تحت تابش مستقیم نور خورشید با توجه به عوامل محیطی و متفاوت آن، کار صحیحی نمیباشد، لذا از شبیه ساز طیف تابشی سلول خورشیدی بدین منظور استفاده شده است. طیفهای استفاده شده در این شبیهساز دیگر تنها طیف نور سفید استفاده شده در مرحله دوم نبوده و به گونهای تنظیم شده است، که بتواند دقیقا تمام گستره فرکانسی نور خورشید در محدوده مرئی را با مشخصه AM: 1.5 در اختیار قرار دهد. منحنیهای نشان داده شده در شکل ۵ مربوط به نمونههایی با/ بدون لایه ضدبازتاب ZnO می باشد، که مشخصه جریان- ولتاژ آنها با استفاده از شبیه ساز سلول خورشیدی رسم شده است. مسلما و قبل از هرگونه آنالیزی، انتظار روندی افزایشی هم در مقدار ولتاژ مدارباز V_{oc} (جریان صفر) و هم ضریب پرشدگی (FF) نمونه با حضور ZnO می رود. چرایی این موضوع را میتوان به جذب بیشتر نور در لایههایی نسبت داد که در آنها از ZnO استفاده شده است، همانطور که قبلا بیان شد، افزایش میزان جذب می تواند باعث افزایش آکسیتون ها شود، و لذا حامل هایی که به اتصال های دو طرف سلول میرسند، افزایش مییابد. مقدار بالاتر V_{oc} در نمونههایی با حضور لایه ZnO حاکی از اختلاف پتانسیل بالاتر این نمونه است، که ناشی از تجمع بیشتر حاملهای بار در دو طرف قطعه میباشد، هرچند که در این لحظه هنوز هیچ جریانی برقرار نشده است. و این می تواند مبین عملکرد خوب یک قطعه سلول خورشیدی باشد. نمودار قائم در شکل ۵ نشان I_{sc} دهنده جریان تولید شده توسط قطعه سلول خورشیدی میباشد. جریان خوانده شده در محل V=0 را جریان مدار کوتاه مینامند. همانطور که مشاهده میشود I_{sc} مربوط به نمونه با حضور لایه ZnO بیشتر از نمونه دیگر است. و این موضوع به همراه مقدار V_{oc} بالاتر می تواند به افزایش مقدار FF که مربوط به سلول خورشیدی با بازده بالاتر است، منجر شود. نتایج آنالیز شده از طیف سلول خورشیدی در جدول ۲ آورده شده است.



شکل۵: منحنی جریان-ولتاژ با استفاده از دستگاه شبیه ساز نور خورشیدی

جدول۲: نتایج گرفته شده توسط دستگاه شبیه ساز طیف خورشیدی

Cell condition	V _{oc} (V)	Isc(mA)	FF	η (%)			
در حضورلایه نازک ZnO	0.41	10.59	0.52	10.04			
در غیاب لایه نازک ZnO	0.39	8.35	0.36	5.22			

۴-نتیجه گیری

در این پژوهش لایههای نازک اکسید روی به عنوان پوشش ضد بازتاب با استفاده از روش سل-ژل و تکنیک پوشش دهی چرخشی که روشی آسان، کم هزینه و قابل تکرار می باشد بر روی سیلیکون لایه نشانی شد و اثر آن بر روی بازدهی سلول های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد، لایه نازک Zn0 تشکیل شده بر روی زیرلایه سیلیکون می تواند خاصیت ضد باز تاب خوبی از خود نشان دهد. نتایج نشان می دهدکه سایز کریستالی نمونه های Zn0 رشد داده شده بین ۳۰ تا ۵۰ نانومتر می باشد و این موضوع می تواند حاکی از یک لایه نشانی یکنواخت باشد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ساختار Zn0 هگزاگونالی بر روی لایه سیلیکون (ept-n) به خوبی رشد پیدا کرده و همه سطح سیلیکون را پوشانده است و سطحی تقریبا صاف در ضخامتی حدود ۲۰۰ نانومتر ایجاد شده است. بنابراین لایه نازک Zn0 می تواند سبب افزایش تولید جریان الکتریکی در سلول های خورشیدی بر پایه تولید هر و به دنبال آن بالاتر رفتن میزان بازده سلول خورشیدی شود. روند دیگری نیز در این فرایند دخیل هستند که جهت دستیایی به نمونه بسیار مطلوب، می بایست همگی آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. نتایج نشان داد که مقاومت سطحی زیرلایه قبل از لایه نشانی اگار می باین میلی ای میدار است. البته عوامل متعدد رسیده است. همچنین راندمان سلول خورشیدی بر پایه تولید هر چه بیشتر جفت الکترون –خوه استوار است. البته عوامل متعدد میران بازد داین فرایند دخیل هستند که جهت دستیایی به نمونه بسیار مطلوب، می بایست همگی آنها را مورد تحلیل و بررسی میرار داد. نتایج نشان داد که مقاومت سطحی زیرلایه قبل از لایه نشانی ای ۸۵ الکترون –خور الده ندینانی به مقدار ای ۸۵ رسیده است. همچنین راندمان سلول خورشیدی درغیاب لایه اکسیدروی ۸۲/۵ درصد و در حضور لایه ضدارتاب اکسیدروی به مقدار ۱۰/۱۰ درصد رسیده است. بعبارتی لایه نازی Zn0 با ساختار هگزاگونال می تواند بعنوان یک لایه ضدارتاب خواص

۵-مراجع

- B. Li.L. Wang, B. Kang, P. Wang, Y. Qiu, *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 90(2006) 549.
 C. Li, M. Liu, N. G. Pschirer, M. aumgarten, K. Mullen, Chemical Reviews, 110(2010) 6817.
- [3] S. R. Forrest, MRS Bulletin, 30(2005) 28.

[4] O. Isabella, K. Jager, A. Smets, R.V. Swaaij, "Solar Energy:Fundamentals, Technology, and Systems", UIT Cambridge, (2016).

- [5] R. Somayye, E. Mohammad, H. Mohaddese, J. Of Applied Chemistry, 5(1389) 15, in Persian.
- [6] P.M. Sirimanne, V.P.S. Perera, Physica Status Solidi (b), 241(2008) 1828.
- [7] D. Eder, Alan H. Windle, Advanced Materials, 20(2008) 1787.

[8] W. Schnabel, Polymers and light: fundamentals and technical applications,1st *ed.*,John Wiley & Sons,(2007) pp.156.

[9] S. De Wolf, A. Descoeudres, Z. C. Holman, and C. Ballif, green, 2(2012)7.

[10] T. Saga, NPG Asia Mater, 2(2010) 96.

[11] H.B.Serreze, "Optimization Solar Cell by Simultaneus Consideration of Grid pattern Design and Interconnect Configuration".(2002), 609.

[12] S. Duttagupta, F. Ma, B. Hoex, T. Mueller, A.G. Aberle, Energy procedia, 15(2012) 78.

[13] D.N. Wright, E.S.Marstein, A. Holt, "Duoble Layer Antireflective Coating for Silicon Solar Cells", IEEE, 2005.

[14] Y.C. Jeon, H.Y. Lee, S.K. Joo, Journal of Applied Physics, 75(1994) 979.

[15] J. Schmidt, F.M. Schuurmans, W.C. Sinke, S.W.Glunz, A.G.Aberle, Applied Physics Letters, 71(1997) 252.

[16] M. Lapeyrade, M.P. Besland, C. Meva'á, A.Sibai, G. Hollinger, Journal Of Vacuum Science & Technology, 17(1999) 433.

[17] W.M Arnoldbik, C.H Maree, A.J Maas, M.J Van den Boogaard, Physical Review B,8(1993)5444.[18] H.P.L Löbl, M. Huppertz, Thin Solids Films 317(1998)153.

[19] S.A. Awan, R.D. Gould, S. Gravano, Thin Solids Films, 335(1999) 456.

[20] T. Ehara, T.Ueno, J. Abe, physica status solidi A, 207(2010) 1600.

[21] C.Yang, J.Pham, Silicon, 10(2018)2561.

[22] J. Lee, Z. Li, M. Hodgson, J. Metson, A .Asadov, W. Gao, Current Applied Physics , 4(2004)398.

[23] R.Thitima, C. Patehatee, S.Takashi, Y. Susumu, Solid-State Electronics, 53(2009) 176.

[24] K. Ellmer, A. Klein, B.Rech, Transparent Conductive Zinc Oxide : Basics and Applications in Thin

Film Solar Cells, Springer Series in Materials Science, (2008) pp.148.

[25] L.Y.Lin, D. E. Kim, Thin Solid Films, 517(2009) 1 690.

[26] J. Li, S. Srinivasan, G. N. He, J.Y. Kang, S. T. Wu, F. A. Ponce, Journal of Crystal Growth, 310(2008) 599.

[27] J. B. Laughlin, J. L. Sarquis, V. M. Jones, J. A. Cox, Journal of Chemical Education, 77(2000) 77.

[28] J. H.Lee, K.H. Ko, B.O.Park, Journal Of Crystal Growth, 247(2003) 119.

[29] M.H. Aslan, A.Y.Oral, E. Mensur, A.Gül, E. Basaran, Solar Energy Materials & Solar Cells, **82**(2004) 543.

[30] M.Caglar, S.Ilican, Y. Caglar, F.Yakuphanoglu, Applied Surface Science, 225(2009)4491.

[31] Ş. Karataş, H. M. El-Nasser, Ahmed. A. Al-Ghamdi, F.Yakuphanoglu, Silicon, 10(2018) 651.

[32] P. Sagar, P. K. Shishodia, R. M. Mehra, Applied Surface Science, 253(2007) 5419.

[33] S.Suwanboonl, R.Tanatth, R.Tanakorn, Songklanakarin, Journal *of* Science *and* Technology, 30(2008) 65.

[34] M.Mohammadi, M.R. Rokn-Abadi, H.Arabshahi, Indian Journal of Science and Technology, 3(2010) 110.